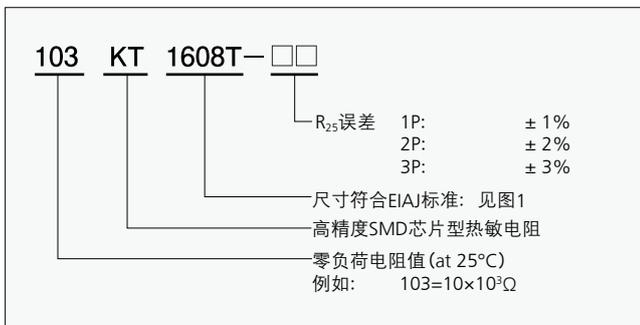


高精度SMD芯片型热敏电阻

KT热敏电阻

KT系列SMD热敏电阻精度高，阻值和B定数误差小 ($\pm 1\%$)，性能高，可靠性高，符合EIAJ标准 (尺寸：1005, 1608)。

形名



应用领域

办公自动化设备、通讯设备、IT设备、移动设备、电池组、充电器、LCD、混合IC、AV设备

规格

形名	R ₂₅ ¹	R ₂₅ 误差	B常数 ²	热消散定数 (mW/°C)	热时定数 (ms) ³	额定功率 (mW) at 25 °C	使用温度范围 (°C)
103KT1608T	10 KΩ	$\pm 1\%$ $\pm 2\%$ $\pm 3\%$	3435 K $\pm 1\%$	约0.9	约5	4.5	-40 ~ 125
503KT1608T	50 KΩ		4055 K $\pm 1\%$				
104KT1608T	100 KΩ		4390 K $\pm 1\%$				
103KT1005T	10 KΩ		3435 K $\pm 1\%$	约0.7	约2.2	3.5	

¹: 25°C下零负荷电阻值 ²: 根据25°C和85°C下零负荷阻值算出 ³: 静止空气中测定

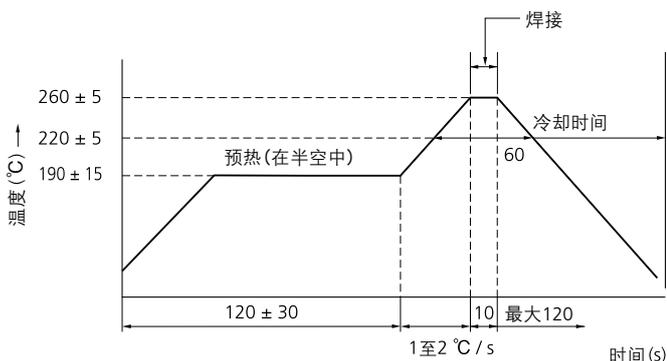
可靠性

项目	试验条件	判定基准
焊接耐热性	260 °C 10s (波峰焊)	$\Delta R, \Delta B \pm 3\%$
焊接性	235 °C 5s 助焊剂材料: 松香 25%、乙醇 75%	焊接率 75% 以上
固着性	安装后, 水平方推动 5N 10s。	$\Delta R, \Delta B \pm 3\%$ 外观
耐电路板弯曲性	安装后, 将电路板从背面弯曲到最大2mm 5s。	
NTC素体强度	使用夹具垂直施加 10N 10s。	$\Delta R, \Delta B \pm 3\%$
高温	125 °C 1000h	
高温高湿	40 °C 相对湿度 90% 1000 h	
温度循环 (热冲击)	50个循环 -25 °C(30min) → 室温 (15min) → 100 °C(30min) → 室温 (15min)	

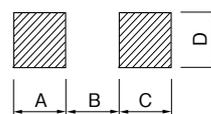
注意

- 焊接前后, 始终确保电路板没有弯曲或翘曲。
- 左侧和右侧的焊盘尺寸应相同。

波峰焊推荐温度曲线



推荐焊盘尺寸



尺寸(EIAJ)	A	B	C	D
1005	0.6	0.5	0.6	0.6
1608	1.0	1.0	1.0	1.2

单位: mm

■ 阻值 / 温度特性

温度 (°C)	形名			
	103KT1608T	503KT1608T	104KT1608T	103KT1005T
- 40	221.9	1920	5218	223.9
- 30	125.1	981.8	2530	126.1
- 20	73.38	525.2	1285	73.87
- 10	44.72	293.3	682.0	44.91
0	28.16	169.7	376.8	28.22
10	18.25	101.7	216.1	18.27
20	12.14	62.90	128.3	12.15
25	10.00	50.00	100.0	10.00
30	8.283	40.05	78.55	8.282
40	5.781	26.20	49.56	5.778
50	4.120	17.56	32.13	4.119
60	2.996	12.04	21.36	2.992
70	2.214	8.431	14.53	2.212
80	1.665	6.021	10.10	1.664
85	1.451	5.122	8.487	1.451
90	1.271	4.376	7.164	1.271
100	0.9832	3.237	5.176	0.9840
110	0.7707	2.433	3.803	0.7710
120	0.6114	1.855	2.839	0.6115
125	0.5469	1.627	2.466	0.5470
B _{25/85}	3435 K	4055 K	4390 K	3435 K

单位: kΩ

■ 编带捆扎尺寸

